****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com [www.congatec.com](http://www.congatec.com)  | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |



*Text und Foto verfügbar:* [*https://www.congatec.com/de/congatec/pressemitteilungen.html*](https://www.congatec.com/de/congatec/pressemitteilungen.html)

Pressemitteilung

congatec Boards mit 8. Gen Intel® Core™ Mobile Prozessor und 10+ Jahre Verfügbarkeit

**Bis zu 58% Leistungssteigerung in erweiterter Verfügbarkeit**

**Deggendorf, 11. Juni 2019 \* \* \*** congatec – ein führender Anbieter standardisierter und kundenspezifischer Embedded Computer Boards und Module – gab heute bekannt, dass die brandneuen Embedded-Versionen der 8. Generation Intel® Core™ Mobile Prozessoren (Codename Whiskey Lake) ab sofort auf COM Express Type 6 Compact Modulen, 3,5 Zoll SBCs und Thin Mini-ITX Motherboards erhältlich sind. OEM-Kunden profitieren von einer sofortigen Leistungssteigerung von bis zu 58%[[1]](#endnote-1) gegenüber früheren Embedded-Prozessoren der U-Serie – ermöglicht durch 4 statt 2 Rechenkernen und eine insgesamt verbesserte Mikroarchitektur. Dank Funktionen wie dem optionalen Intel® Optane™ Memory 2 oder USB 3.1 Gen2 sind alltägliche Aufgaben noch schneller erledigt. Zudem ermöglichen die Prozessorkerne ein effizientes Task-Scheduling und unterstützen darüber hinaus den Einsatz der RTS-Hypervisor-Software, um den I/O-Durchsatz von den Eingangskanälen zu den Prozessorkernen zusätzlich zu optimieren.

Die neuen High-End Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3 und Celeron® Embedded Prozessorboards und -module sind für raue und platzbeschränkte Umgebungen entwickelt und die ersten am Markt, die eine Langzeitverfügbarkeit von mehr als 10 Jahren bieten. Dieses brandneue Embedded x86-Designprinzip feiert mit der Einführung der neuen Intel® Core™ Mobile Prozessorboards der 8. Generation sowohl bei congatec als auch im gesamten Bereich der Embedded-Board-Hersteller[[2]](#endnote-2) Premiere. Die neuen Boards und Module tragen insbesondere den gestiegenen Lebenszyklusbedürfnissen des Transport- und Mobilitätssektors Rechnung, sie eignen sich aber auch perfekt für alle weiteren Embedded-Anwendungen, wie z.B. medizinische Geräte und Industriesteuerungen, Embedded Edge Clients und HMIs, da sie verlängerte Lebenszyklen ohne zusätzliche Kosten für die Kunden ermöglichen.

„Eines unserer Hauptziele ist es, den Einsatz von Embedded-Computer-Technologie für unsere OEM-Kunden so weit wie möglich zu vereinfachen. Da 7 Jahre für viele High-End Embedded Computing Bereiche oft nicht mehr ausreichen, bieten wir unsere brandneuen 8. Gen Intel® Core™ Mobile Prozessor-basierten Embedded Boards und Module jetzt von Anfang an mit einer 10+ Langzeitverfügbarkeit und – auf Basis eines spezifischen Long Time Buy Vertrages – sogar mit bis zu 15 Jahren.. Unser verlängerter Lebenszyklus –übrigens ohne zusätzliche Kosten – hilft OEMs also, ihre eigenen Produktlebenszyklen für einen noch besseren ROI zu verlängern“, erklärt Christian Eder, Director Marketing bei congatec.

In der Vergangenheit tendierten viele High-End-Embedded-Anwendungen zu Lebenszyklen von weniger als 7 Jahren, da sie zuvor oft einen neuen Leistungsschub von Prozessoren der nächsten Generation benötigten. Aber mit den gestiegenen Zertifizierungsanforderungen in diversen neuen Embedded-Anwendungsbereichen, wie z.B. mobilen Fahrzeugen, sind OEMs heute sehr an längeren Lebenszyklen interessiert. Die Verlängerung der Lebenszyklen von Standard Embedded x86-Plattformen auf 10 oder gar 15 Jahre ab Lager ist folglich ein großer Vorteil für Kunden im gesamten Embedded Computing-Markt.

„Wir freuen uns sehr, Embedded-Versionen dieser brandneuen Intel-Architektur mit einer Langzeitverfügbarkeit von mehr als 10 Jahren an der Hand zu haben. Längere Lebenszyklen sind eine Schlüsselanforderung in vielen mobilen Anwendungen, die wir in rauen Umgebungen anvisieren, in denen Hochgeschwindigkeits-Datenströme erfasst und protokolliert werden müssen, um 3D-Objekte zu erkennen, Lidar-Bildgebung und mobiles Mapping durchzuführen. Die gleiche Anforderung, die auch unsere Endkunden von unseren Datenrekordern für die drahtlose Netzwerküberwachung, für Automotive-Testsysteme oder Datenlogger für Testfahrzeuge erwarten, die Hochgeschwindigkeits-Datenströme von externen Sensoren auf Solid-State-Laufwerken oder Festplatten speichern und analysieren“, erklärt Thomas Hagios, Geschäftsführer der MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH.

**Das Featureset im Detail**

Die neuen COM Express Type 6 Module conga-TC370, die Embedded 3,5 Zoll SBCs conga-JC370 und die Thin Mini-ITX Mainboards conga-IC370 sind alle mit den neuesten Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3 und Celeron Embedded Prozessoren bestückt, die eine Langzeitverfügbarkeit von 15 Jahren bieten. Der Speicher ist so konzipiert, dass er den Anforderungen bei der Konsolidierung von Multi-Betriebssystem-Anwendungen auf einer einzigen Plattform entspricht: Zwei DDR4 SODIMM-Sockel mit bis zu 2400 MT/s stehen für insgesamt bis zu 64GB zur Verfügung. Erstmals wird nun USB 3.1 Gen2 mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s nativ unterstützt, was es ermöglicht, auch unkomprimierte UHD-Videostreams von einer USB-Kamera oder einem anderen Vision-Sensor zu übertragen. Die neuen 3,5-Zoll-SBCs bieten diese Leistung über einen USB-C-Anschluss, der auch 1x DisplayPort++ und die Stromversorgung für Peripheriegeräte unterstützt und so eine Monitorverbindung mit einem einzigen Kabel für Video, Touch und Power ermöglicht. COM Express-Module unterstützen dieselben Funktionen auf entsprechend ausgelegten Carrierboards. Weitere Schnittstellen sind formfaktorabhängig, unterstützen aber insgesamt 3 unabhängige 60Hz UHD-Displays mit bis zu 4096x2304 Pixel sowie Gigabit Ethernet (1x mit TSN-Unterstützung). Die neuen Boards und Module bieten all dies und viele weitere Schnittstellen mit einer ökonomischen TDP von 15W, die von 10W (800 MHz) bis 25W (mit bis zu 4,6 GHz im Turbo Boost Modus) skalierbar ist.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozessor** |  | **Cores / Threads** |  | **Basistakt / Max. Turbotakt[GHz]** |  | **Base-TDP** **[W]** |  | **Temperatur-bereich** |
| **Intel® Core™ i7 8665UE** |  | 4 / 8 |  | 2,0 / 3,4 |  | 15 |  | 0 bis +60°C |
| **Intel® Core™ i5 8365UE** |  | 4 / 8 |  | 1,8/ 2,6 |  | 15 |  | 0 bis +60°C |
| **Intel® Core™ i3 8145UE** |  | 2 / 4 |  | 1,8 / 2,2 |  | 15 |  | 0 bis +60°C |
| **Intel® Celeron® 4305UE** |  | 2 / 2 |  | 1,8 |  | 15 |  | 0 bis +60°C |

Weitere Informationen zu den neuen 8 Gen Intel Core Prozessoren und den korrespondierenden Boards und Modulen finden Sie unter: <https://www.congatec.com/intel-whiskey-lake>

**Über congatec**

congatec ist ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren COM Express, Qseven und SMARC sowie für Single Board Computer und Customizing-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland unterhält Niederlassungen in den USA, Taiwan, China, Japan und Australien sowie in Großbritannien, Frankreich und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel, Intel Core und Inrel Celeron sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*

Vollständige Konfigurationen für Starteransprüche: Intel® Core™ i7-8665UE Prozessor, PL1= 15W TDP, 4C8T, Turbo bis 4,4GHz, Intel® UHD Grafik 620, Intel Referenzplattform, Speicher: 2x4GB DDR4-2400, Speicher: 512GB Intel 545s SSD, OS: Microsoft Windows\* 10 Pro RS5 Build Version 1809 vs. Intel® Core™ i7-7600U Prozessor, PL1=15W TDP, 2C4T, Turbo bis 3,9GHz, Intel® HD Grafik 620, Motherboard: Intel Referenzplattform, Speicher: 2x8GB DDR4-2133, Speicher: 512GB Intel 545s SSD, OS: Microsoft Windows\* 10 Pro RS5 Build Version 1809

1. SPEC\* CPU2000/2006 ist ein Benchmark des SPEC-Konsortiums, das die Geräteleistung und den Durchsatz mit rechenintensiven Anwendungs-Subtests misst.  SPECint\*\_base2000/2006 misst, wie schnell ein Gerät eine einzelne ganzzahlige Rechenaufgabe erfüllt.  SPECint\*\_rate\_base2000/2006 misst den Durchsatz oder wie viele ganzzahlige Rechenaufgaben ein Gerät in einer bestimmten Zeitspanne bewältigen kann.  Betriebssystemunterstützung:  Desktop Windows\*, UNIX\*/Linux\* und Mac\* OS

Vollständige Konfigurationen zum Launchzeitpunkt: Intel® Core™ i7-8665UE Prozessor, PL1= 15W TDP, 4C8T, Turbo bis 4,4GHz, Intel® UHD Grafik 620, Intel Referenzplattform, Speicher: 2x4GB DDR4-2400, Speicher: 512GB Intel 545s SSD, OS: Microsoft Windows\* 10 Pro RS5 Build Version 1809 vs. Intel® Core™ i7-7600U Prozessor, PL1=15W TDP, 2C4T, Turbo bis 3,9GHz, Intel® HD Grafik 620, Motherboard: Intel Referenzplattform, Speicher: 2x8GB DDR4-2133, Speicher: 512GB Intel 545s SSD, OS: Microsoft Windows\* 10 Pro RS5 Build Version 1809 [↑](#endnote-ref-1)
2. Laut Recherche von congatec anhand der neuesten Datenblätter aller großen Anbieter [↑](#endnote-ref-2)